

技术要求:

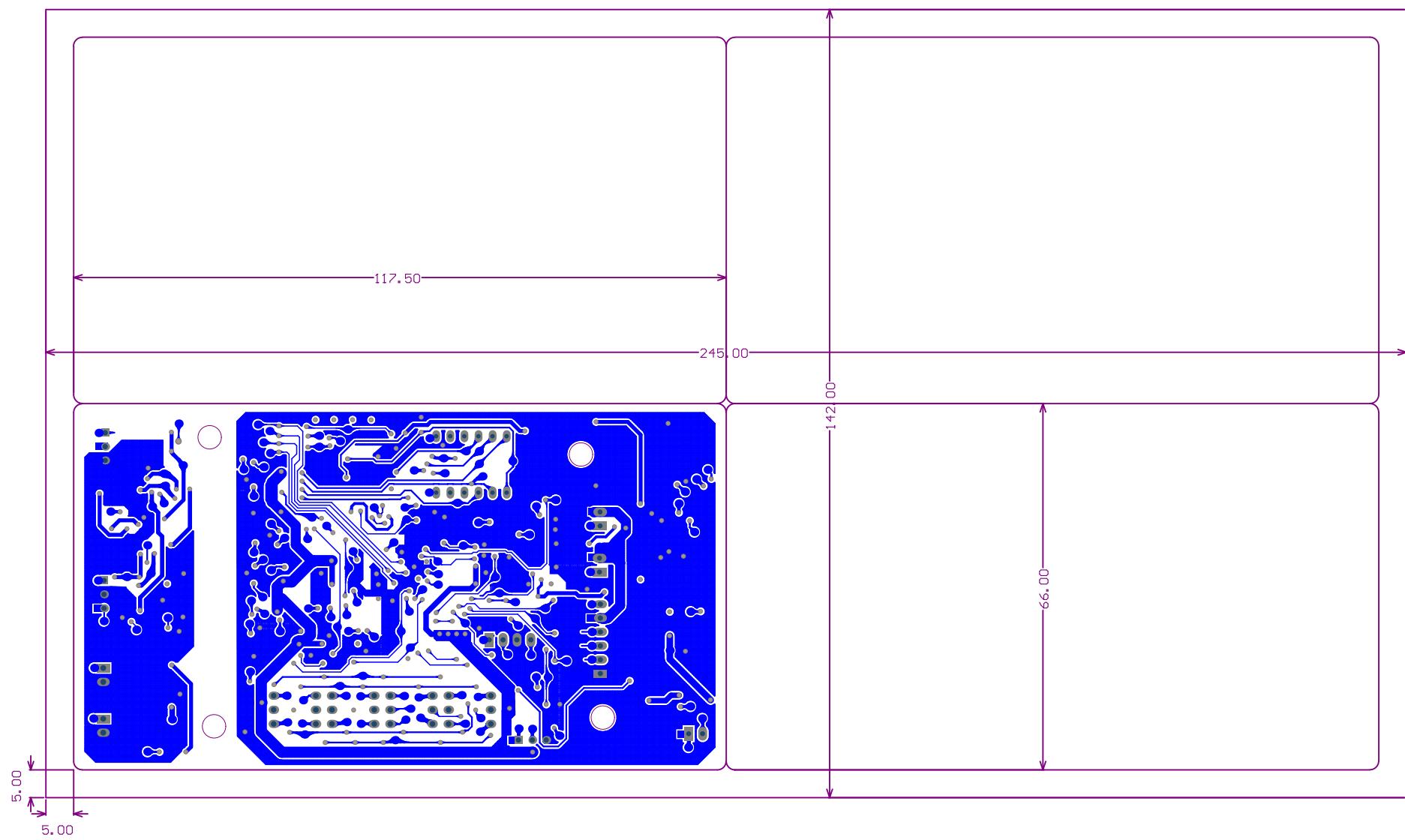
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
- 4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

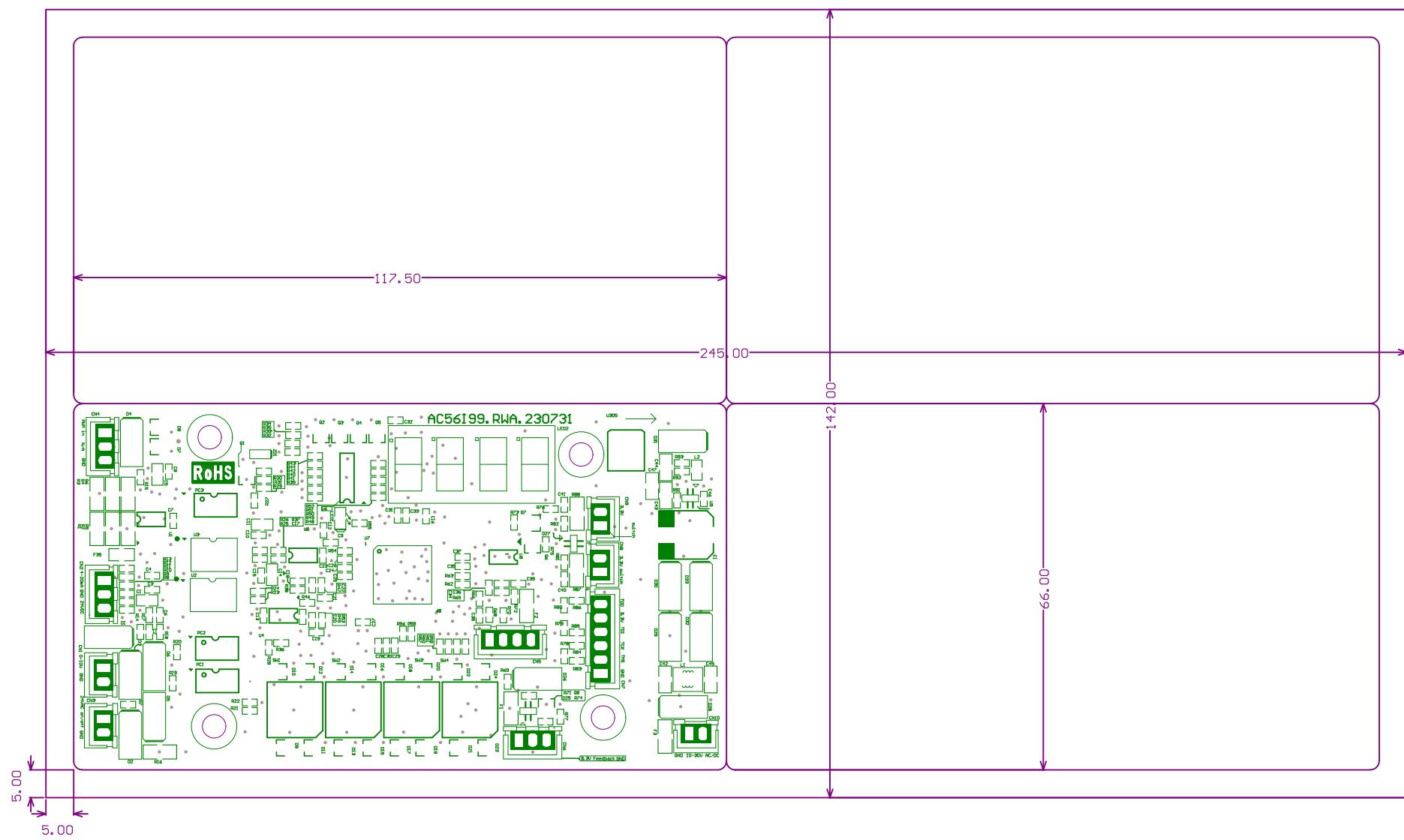
7.拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
- 5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
- 6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01 图号:	图层: Top Layer
校对		日期				
审核		日期		V01	材质: 双面环氧四拼板 工艺: 无铅喷锡	板厚: 1.6mm 铜箔厚: 35um
批准		日期		图 样 标 记	数 量	比 例
				共 5 页	第 1 页	上海儒竞智控技术有限公司





技术要求:

- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
- 4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;
- 5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%;
- 6、符合ROHS/UL/CQC要求;
- 7.拼板方式为正正顺拼

设计

日期

7.拼板方式为正正顺拼

2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%

3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
6、符合ROHS/UL/CQC要求;

AC56I99.RWA.230731

To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01

HW-AC56I99-19600002,V01
图号:

图层:
Top
Overlayer

校对

日期

V01

材质: 双面环氧四拼板 板厚: 1.6mm

审核

日期

图 样 标 记 数 量 比 例

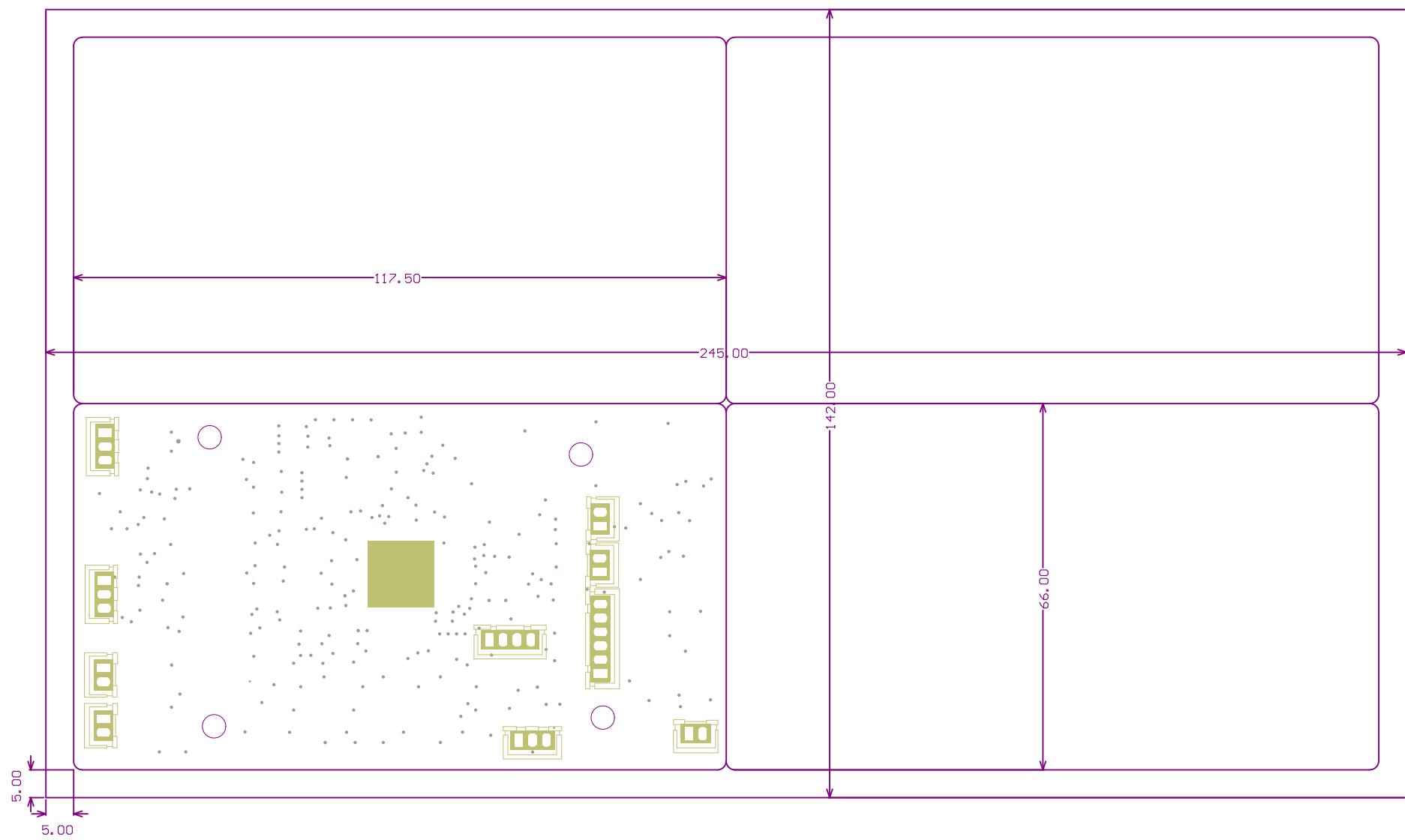
工艺: 无铅喷锡 铜箔厚: 35um

批准

日期

共 5 页 第 3 页

上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

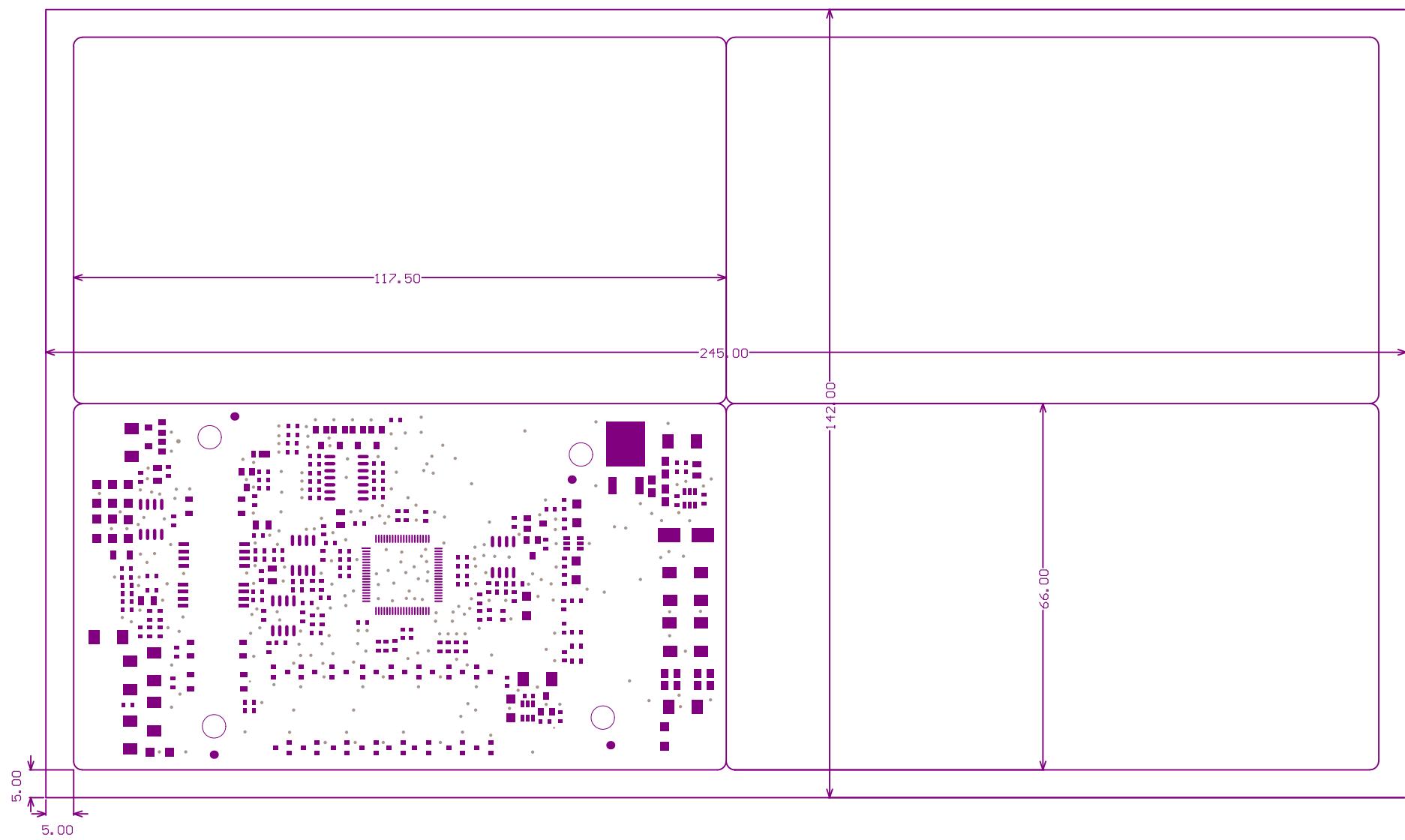
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7.拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01	图层: Bottom Overlayer
校对		日期			V01	
审核		日期		图 样 标 记	数 量	比 例
批准		日期		共 5 页	第 4 页	上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

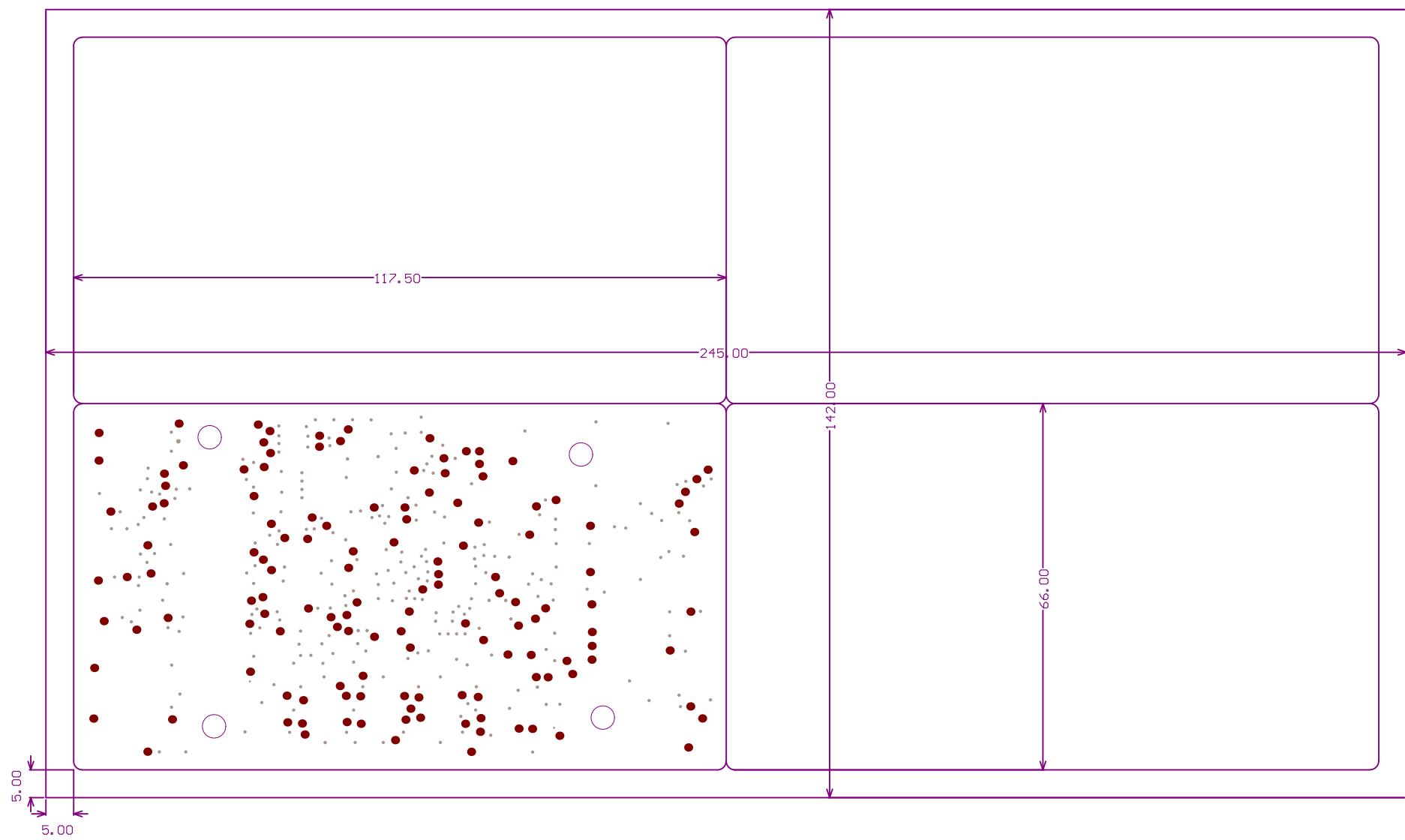
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7.拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01		图层:
校对		日期			V01		材质: 双面环氧四拼板 板厚: 1.6mm
审核		日期		图 样 标 记	数 量	比 例	工艺: 无铅喷锡 铜箔厚: 35um
批准		日期		共 5 页	第 <input type="text"/> 页		上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

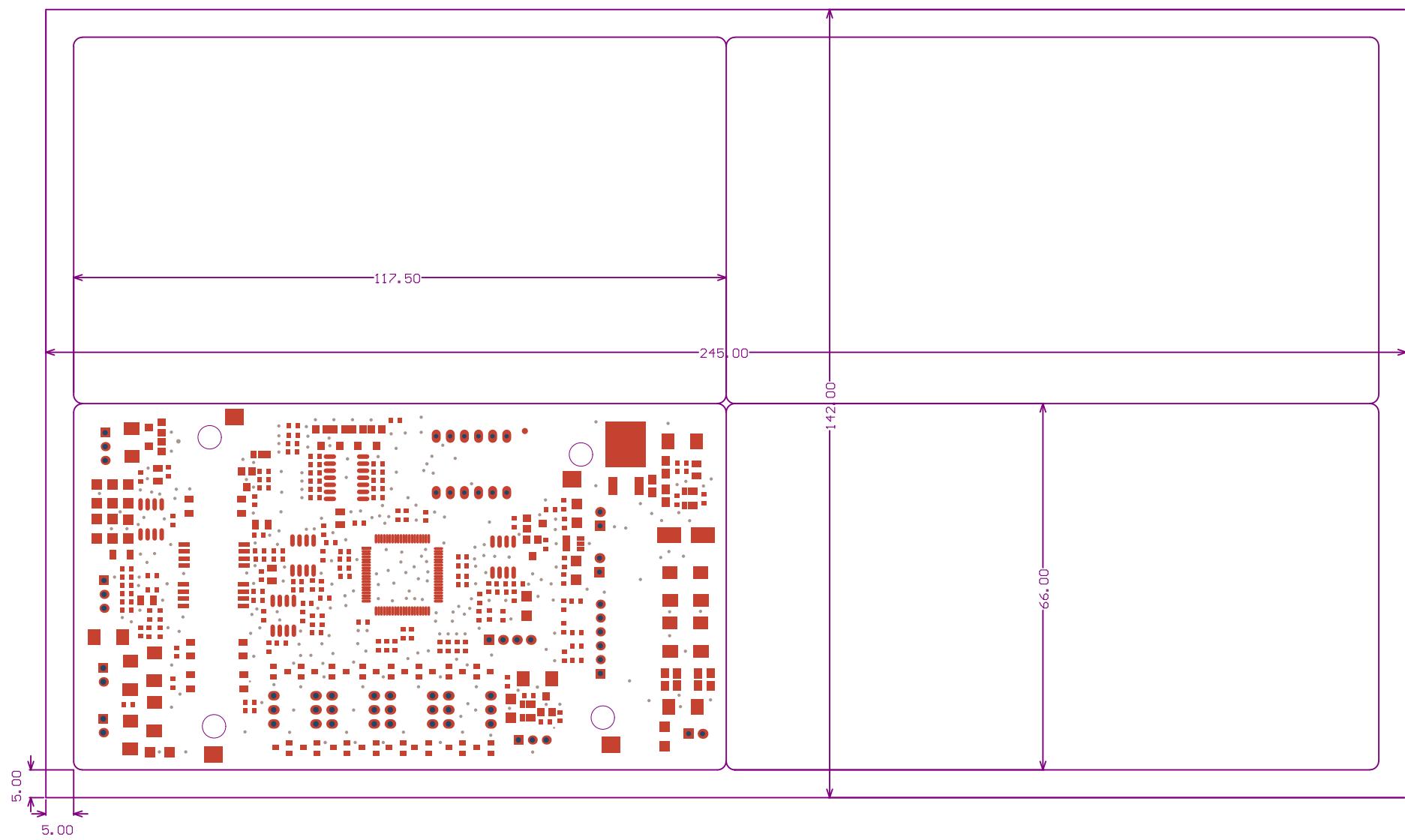
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
- 4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7.拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
- 5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
- 6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01	图层: 图号:
校对		日期				
审核		日期		V01		材质: 双面环氧四拼板 板厚: 1.6mm
批准		日期		图 样 标 记	数 量	比 例
				共 5 页	第 <input type="text"/> 页	上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

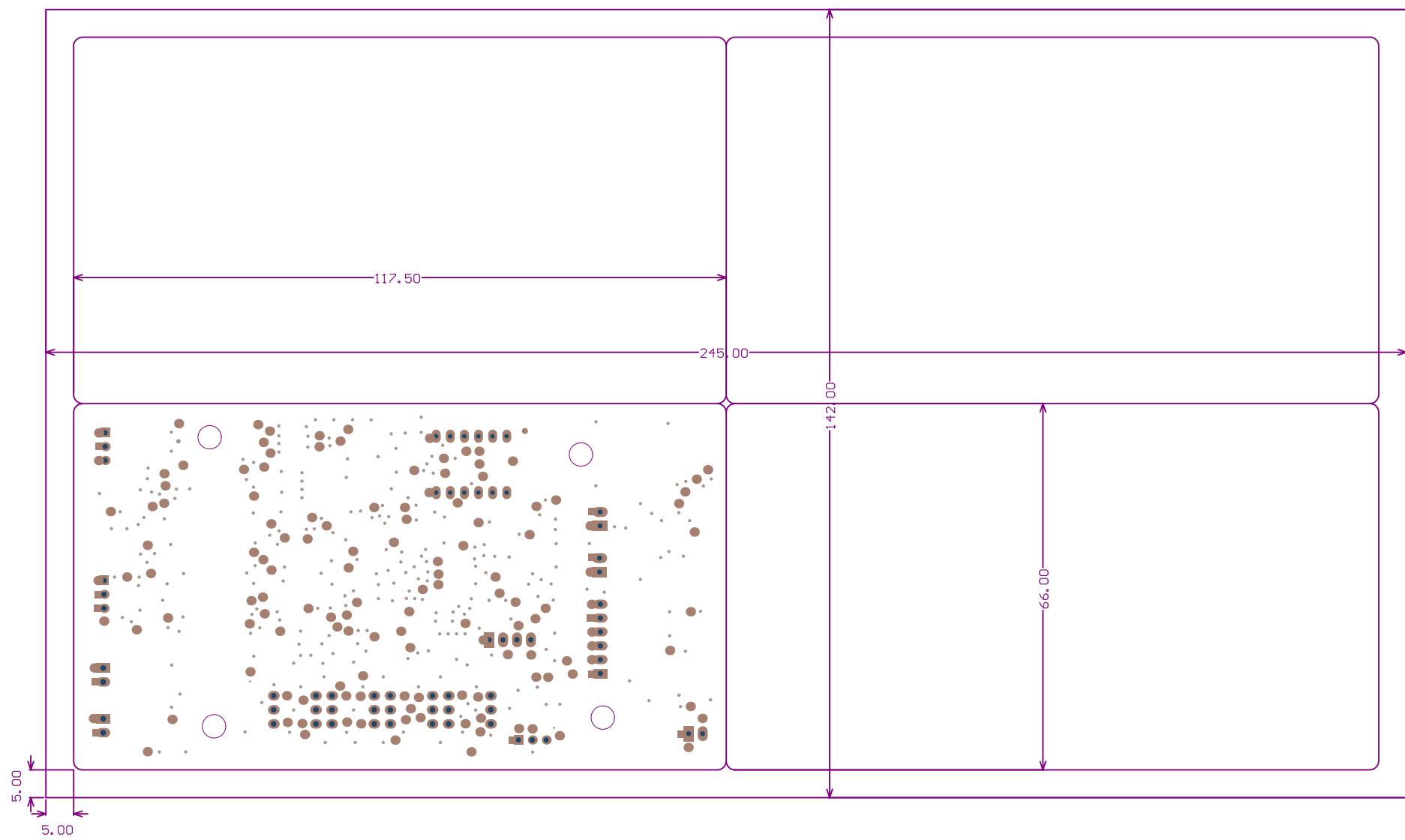
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
- 4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7. 拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
- 5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0; CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
- 6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01	图层:
校对		日期			V01	
审核		日期		图 样 标 记	数 量	比 例
批准		日期				
				共 5 页	第 <input type="text"/> 页	上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

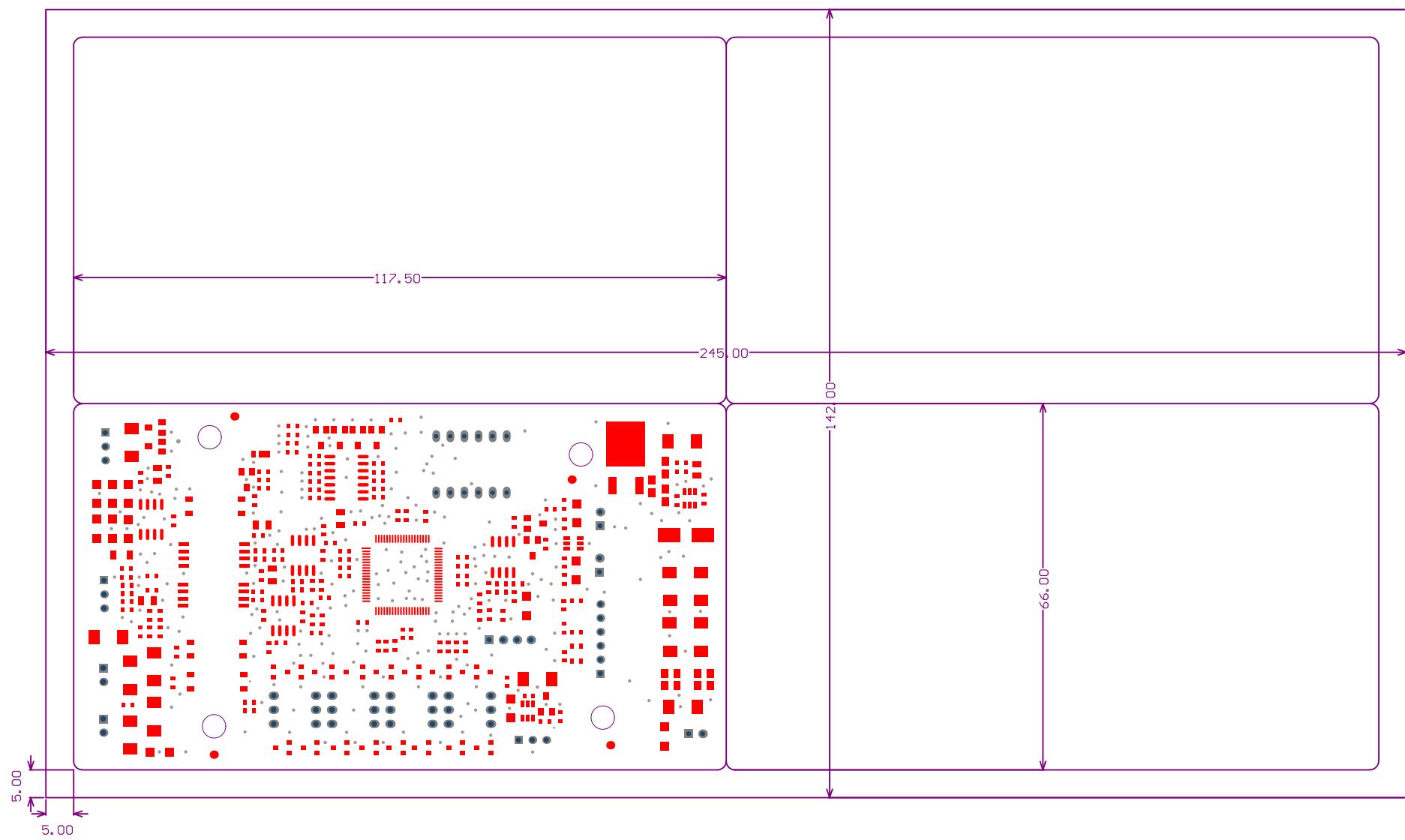
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7.拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0;CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01 图号:	图层: Bottom Solder
校对		日期				
审核		日期		V01	材质: 双面环氧四拼板 工艺: 无铅喷锡	板厚: 1.6mm 铜箔厚: 35um
批准		日期		图 样 标 记	数 量	比 例
				共 5 页	第 5 页	上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

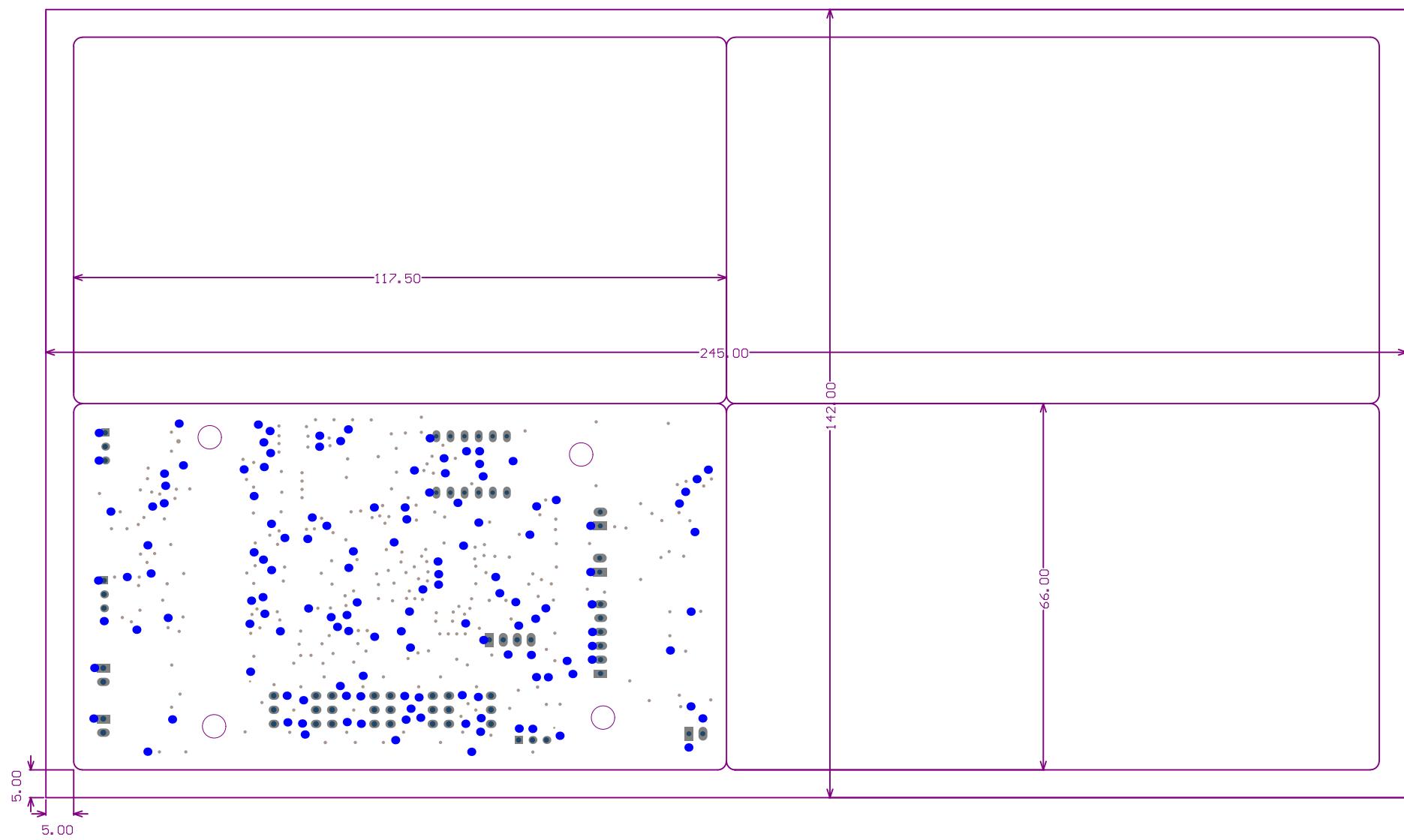
- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
- 4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7. 拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
- 5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0; CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
- 6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01	图号:	图层:
校对		日期					
审核		日期		V01		材质: 双面环氧四拼板	板厚: 1.6mm
批准		日期		图 样 标 记	数 量	比例	
							工艺: 无铅喷锡
							铜箔厚: 35um
				共 5 页	第 页		上海儒竞智控技术有限公司



技术要求:

- 1、PCB板铜箔厚是指基铜厚度;
- 4、无特殊说明外,顶层和底层丝印颜色均为白色;

7. 拼板方式为正正顺拼

- 2、PCB板所有过孔及槽的尺寸均为PCB板完成后的净尺寸;
- 5、所用板材必须阻燃,且符合UL94V-0; CTI>175V;吸水率<0.5%

- 3、无特殊说明外,阻焊颜色为绿色;
- 6、符合ROHS/UL/CQC要求

设计		日期		AC56I99.RWA.230731 To SCH: HW-AC56I99-17600002,V01	HW-AC56I99-19600002,V01		图层:
					V01		
校对		日期			材质: 双面环氧四拼板	板厚: 1.6mm	
审核		日期			工艺: 无铅喷锡	铜箔厚: 35um	
批准		日期		共 5 页	第 页	上海儒竞智控技术有限公司	